2024年6月26日-28日第6届国际半导体技术展览会盛大召开

产品名称	2024年6月26日-28 日第6届国际半导体技术展览会盛大召开
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

随着行业经济逐步复苏，半导体行业迎来新的机遇。SEMI-e
深圳国际半导体展作为半导体行业重要的展示交流平台，将于2024年6月26日-28
日在深圳国际会展中心（宝安新馆）盛大开幕！

2024第6届深圳国际半导体技术展览会展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

五月"芯"机强势登陆鹏城！届时深圳国际半导体展展会规模将达60,000平方米，汇聚近1000
家展商，预计吸引来自IC设计、封装测试厂商，消费电子、机器视觉、半导体加工制造、qiche工业、通讯电子、医疗电子、工业电子、新能源、轨道交通、新能源等应用领域专业观众达50,000人次前来参观。多场主题峰会汇聚众多xingyezhuanjia和学者，聚焦行业热点，充分展示智能信息化时代下半导体产业的最新成果及趋势，同期还将举办第七届深圳国际电子与工业智造展，实现电子行业供应链资源互补，为参展商和参会观众提供新趋势、发掘新商机！

本届展会以【"芯"机会 · "智"未来】为主题，展示芯片设计、衬底、外延、封装、测试、器件/模块、材料以及生产设备等全产业链上下游。生产研发销售三端互动，展会现场即可达成贸易合作及市场开发双向赋能，深入洞悉半导体市场未来发展新风向！半导体产业链全覆盖，一站式对接优质资源，快来抢占后疫情时代经济复苏后的行业"芯"机！

六大特色展区 解锁行业"芯"机遇

随着国家经济回暖，源利好政策的叠加，新能源技术迎来新的发展和增长阶段。第三代半导体技术被广泛应用在不同的领域，整个产业开始驶入快车道。

为促进提升创新能力，推动半导体制造国产化，推进半导体产业高质量发展，本届深圳国际半导体展特

设电子元器件、IC 设计 & 芯片、晶圆制造及封装、半导体设备、半导体材料、第三代半导体六大特色展区，覆盖新能源应用、数据中心、5G 新应用、AIoT、新型显示 Mini/Micro、消费类电子等热点应用领域。融合产品实物展示、实操演示，学术峰会交流，供需匹配，产业商机即时透传等多维度交流手段，助您一站解锁行业 " 芯 " 机遇。

四大主题峰会，共探 " 芯 " 趋势

为了更好助力行业发展，洞悉市场发展趋势，展会同期举办四大主题峰会，" 第6届 5G&半导体产业技术高峰会 "、"2024 国际电源技术高峰论坛 "、" 第四届第三代半导体产业发展高峰论坛 "、"TWS 耳机产业高峰技术论坛 " 覆盖集成电路芯片设计、半导体材料、5G 应用、智能消费电子、qiche 电子、无线充电等领域话题，汇聚专家大咖探讨行业发展趋势，资讯分享和热点互动，带来市场趋势jie ma、优质资源现场对接。

抢占 " 芯 " 商机、布局 " 芯 " 规划、前瞻 " 芯 " 趋势，6 月26 日 -28 日，深圳国际会展中心！与您不见不散